**“生物工程创造美好未来——创新驱动下的机遇与挑战”**

**全国博士后学术论坛第一轮通知**

“生物工程创造美好未来——创新驱动下的机遇与挑战”全国博士后学术论坛将于2018年6月22日—2018年6月24日在华东理工大学举行。论坛以“生物工程创造美好未来”为主题，旨在为国内外广大从事生物化工、生物工程、发酵工程、合成生物学、生物能源及生物过程等相关领域研究学者和博士后研究人员提供一个学术交流的平台，加强生物工程相关领域研究方向的交流与合作，展现研究人员研究成果的同时，促进学科交叉融合，积极推进创新思路的培养，推动本领域研究的发展。

本次论坛由全国博士后管委会办公室、中国博士后科学基金会、上海市人力资源和社会保障局主办，华东理工大学承办。论坛拟采取大会特邀报告、分组报告的形式进行，现面向上述相关领域的博士后研究人员和研究学者开展主题征文，热忱欢迎大家踊跃投稿，积极参与论坛活动。

**一、论坛主题**

围绕“生物工程创造美好未来”这一主题，报告研究方向自选。

**二、论坛内容**

（一）主题报告：专家作报告和讲座

（二）学术交流：博士后研究人员和研究学者等宣读论文、分组交流研讨等。

（三）论文颁奖：对评选出的优秀论文颁奖。

（四）学术参观：生物反应器工程国家重点实验室参观。

**三、论文征集**

（一）征文对象：相关领域专家学者、博士后人员。

（二）论文要求

1. 参加学术论坛的代表应向大会提交研究论文摘要一篇（中英文均可）；论文内容应与本次论坛主题相关，体现本学科领域的发展前沿，并具有一定创新性。可以是在公开出版报刊、论文集或网络上发表的，也可以是正在研究的科研报告，摘要文稿要符合学术规范；请以Word格式提交，注释或参考数据等务请明确详实(论文摘要模版见附件)；

2．参会回执提交截止时间：2018年 5月30日；

3．论文提交截止时间：2018年 5月30日；

（三）来稿首页注明联系方式（包括作者姓名、性别、单位、电话、E-mail等）；论坛只接受电子版，发送邮箱：ecust\_pd2018@163.com， 邮件主题注明“姓名-华理博士后论坛”，注意索要回复；

（四）将制作成论文摘要集供内部交流；

（五）未正式发表的优秀论文（英文撰写的）可以推荐给Bioresources and Bioprocessing期刊发表。

**四、其他事宜**

（一）会议不收取注册费、资料费，会议期间餐饮、住宿由大会统一安排，交通费用自理。

（二）论坛QQ群276546630，名称：华理博士后论坛2018，申请时请输入姓名、单位，会后解散。

联系人：夏建业，021-64251946，张楠，021-64252556。

扫描二维码加入QQ群：

（三）论坛地点：上海市徐汇区梅陇路130号华东理工大学逸夫楼

生物工程创造美好未来——创新驱动下的机遇与挑战

博士后论坛组委会

二〇一八年三月二十日

“生物工程创造美好未来——创新驱动下的机遇与挑战”

全国博士后学术论坛回执

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | 出生年月 |  | | | 职务/职称 |  |
| （学习）工作单位 | |  | | | | | | | | |
| 通信地址 | |  | | | | | 邮编 |  | | |
| 学历 | |  | | | | | 研究方向 |  | | |
| 博士学位授予单位 | |  | | | Email | |  | | | |
| 是否参加人才招聘活动 | | □是 □否 | | | 是否住宿 | | □是 □否 | | | |
| 是否有博后经历 | | □是 □否 | | |  | |  | | | |
| 论文摘要题目 | |  | | | | | | | | |
| 是否作报告 | | □是 □否 | | | | | | | | |
| 拟报告题目 | |  | | | | | | | | |

附件1：

**论文摘要模版**

# 文章的中文标题(小2号，黑体，加粗，居中)

##### 作者1中文名，作者2中文名，作者3中文名

###### (单位 单位所在地 邮编)(6号宋体，Times New Roman)

【摘要】中文摘要(200个中文字以上，中文是小5号，楷体，英文是Times New Roman) 。

关 键 词中文关键词1; 中文关键词2; 中文关键词3; 中文关键词4; 中文关键词4(4～7个)

中图分类号(我刊网站上可查询) 文献标识码A

**文章的英文标题(3号，Times New Roman，加粗，居中)**

作者1英文名， 作者2英文名， 作者3英文名， and作者4英文名(姓在前名在后，姓全部大写)

(单位的英文翻译 英文地址 邮编) (6号宋体，Times New Roman)

**Abstract** 英文摘要(与中文摘要相对应，5号，Times New Roman).

**Key words**  英文关键词1; 英文关键词2; 英文关键词3; 英文关键词4; 英文关键词5(与中文关键词相对应，5号，楷体，Times New Roman)

参 考 文 献

(中文：小5号楷体，英文：Times New Roman)

[1] SONG B S， GRAY P R. A precision curvature-compensated CMOS bandgap reference[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits， 1983， 18(6): 634-643.

[2] AVOINNE C， RASHID T， CHOWDHURY V， et al. Second-order compensated bandgap reference with convex correction[J]. Electronic Letters， 2005， 41(5): 276-277.

[3] KER Ming-dou， CHEN Jung-sheng， CHU Ching-yun. New curvature-compensation technique for CMOS bandgap reference with sub-1-V operation[C]//The 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Newyork: IEEE， 2005， 4: 3861-3864.

[4] 秦 波， 贾 晨， 陈志良， 等. 1 V电源非线性补偿的高温度稳定性电压带隙基准源[J]. 半导体学报， 2006， 27(11): 2035-2039.

QIN Bo， JIA Cheng， CHEN Zhi-liang. A 1 V MNC bandgap reference with high temperature stability[J]. Chinese Journal of Semiconductors， 2006， 27(11): 2035-2039.